# Припой в брусках бессвинцовый Jufeng Solder





**Описание**

Бессвинцовые припои постепенно вытесняют оловянно-свинцовые припои из-за возрастающей важности охраны окружающей среды по всему миру. Содержание канифольного флюса в большинстве бессвинцовых припоев составляет 2%.

Принимая во внимание современные требования, содержание свинца в припоях Jufeng менее 100 мг/кг. Припой обычно используется для пайки электронных компонентов, компьютеров, медных пластин, печатных плат и другого оборудования. Характеризуется отличной смачиваемостью, высокой скоростью пайки, превосходным антиоксидантными свойствами, высоким пределом прочности на растяжение и др. Кроме того, олово не разбрызгивается в процессе пайки.

Бессвинцовые припои в брусках производства можно разделить по видам используемых сплавов, а именно Sn99%,Sn-Cu, Sn-Ag-Cu, Sn-Ag, Sn-Bi и другие. Некоторые типы припоев могут быть изготовлены с толщиной проволоки 0,1 мм.

**Фасовка**

* Брусок 700 г;

**Технические характеристики**

**Sn96.5Ag3.0Cu0.5**

* Температура плавления: 217°C

**Sn96.5Ag3.5**

* Температура плавления: 227°C

**Sn99Ag0.3Cu0.7**

* Температура плавления: 217°C

**Sn99.3Cu0.7**

* Температура плавления: 227°C

**Sn99.95**

* Температура плавления: 232°C

**Sn97Cu3**

* Температура плавления: 300°C

**Sn42Bi58**

* Температура плавления: 138°C

**Sn90Sb10**

* Температура плавления: 250°C

**Sn95Sb5**

* Температура плавления: 240°C